

九域半导体科技（苏州）有限公司 简介

公司成立于 2021 年，是一家注册在苏州。目前国内唯一一家从事非接触式半导体电学量测分析设备制造商。主要攻克国外垄断关键核心技术，替代进口产品，助力半导体材料测试先关设备国产化。

主要产品有	涉及测量方法	应用领域	主要客户群体
❖非接触式晶圆方块电阻\电阻率分析仪	❖非接触式涡流法	❖ 半导体衬底材料	❖ 半导体晶圆制造
❖非接触式晶锭电阻率分析仪	❖非接触式 SPV 法	❖ 半导体晶锭材料	❖ 半导体材料研究
❖SPV 法 PN 类型测试仪	❖非接触式电容法	❖ 半导体外延材料	❖ 光伏晶锭
❖非接触式迁移率（霍尔）测试仪	❖非接触式微波霍尔法	❖ 新能源光伏材料	❖ 光伏硅片分选
❖非接触式硅片厚度测试仪		❖ 导电薄膜材料	❖ 光伏电池片
❖非接触式 JPV 法方阻分析仪		❖ 射频 HEMT 结构材料	❖ 外延生产
❖EFEM 晶圆传输系统		❖ 碳纳米管及金属等	❖ 高校及科研

主要产品 简介

产品名称及型号	型号	应用领域	与进口对标设备	已用主要客户
非接触式涡流法方阻测试仪 (可集成 EFEM 系统, 厚度测量、晶 锭测量)	ER1110	半导体材料衬底及外延测试 (Si, SiC, GaN, 晶锭)	Semilab LEI-1510 系列	
			Napson NC-80MAP	
非接触式涡流法电阻率测试探头	ER-P1000	光伏分选机, Si 片分选	Napson EC-80P	
非接触式 SPV 法 PN 测试探头	ER-P0100	光伏分选机, Si 片分选	Napson PN-50a	
非接触式霍尔法迁移率测试仪	HM-2000	射频 GaN HEMT 结构外延 片测试	Semilab LEI-1610E100AM 系列	
非接触式 JPV 法表面方阻测试探头	SP-P3000	电池片 P 扩或 N 扩后表面方 阻	Semilab CMS-1AP	

产品竞争优势

明星产品	技术水平	知识产权	服务承诺
❖ 全球首台锭+片+厚度一体机 主要应用于 SiC 衬底测量可集成晶锭、晶片、厚度和 EFEM 一体测量，具有极大的成本优势、及数据有效性。 ❖ 国内首台高速光伏硅片测量模组 集成电阻率探头、PN 探头、温度探头于一体。半导体级别电阻率探头，数据采集时间 1ms/点，量程可定制。LED 光源 PN 探头，使用寿命超过 10 年。准确测温方案有利于数据更加准确。 ❖ 国内首台非接触式霍尔迁移率 世界第二家具有研发该设备能力的厂商。已突破关键核心技术及算法，助力射频 HEMT 结构材料的准确测量。	❖ 硬件优势： ✓ 一致性、稳定性、抗干扰性、寿命长、使用维护简便为主要设计目的 ✓ 布局采用分层一体化设计，抗干扰能力强 ✓ 专用测量表头，信号稳定性更高 ✓ 信号自动调节，无需手动维护 ✓ 探头自动可调，量程扩大 2-10 倍 ✓ 军工级芯片及高位采样保证数据重复性 ✓ 电子元器件级使用寿命 ❖ 软件优势： ✓ 可定制语言、功能 ✓ 可测非标尺寸样片，集成检测尺寸，自动找中心，摆放位置检测等功能 ✓ Mapping 系统可设置，色卡对应关系、等高线参数等均可配置 ✓ 去边算法优化和开放，可测样片 2mm 边缘 ✓ 可集成 EFEM,平坦度等系统	❖ 自主知识产权授权 17 项 ❖ 自主知识产权受理 10 项 ❖ 部分产品取得 CE 认证 ❖ 半导体相关安规认证 ❖ 年知识产权超过 8 个/年 ❖ 多个产品已申请国内首台	❖ 性能指标不低于对标设备 ❖ 免费样片长期测试 ❖ 采购货期短（进口的 1/6） ❖ 2 小时内响应设备问题及客户需求 ❖ 8 小时内出解决方案 ❖ 质保期内无条件上门服务 ❖ 没有进口设备服务难、服务慢等问题